



CMP 晶圆抛光压力分布量测与分析应用

I-Scan®系统提供矽晶圆抛光制程一个必要的利器，这套系统能够协助您评估、观测并平衡矽晶圆上所承载的受力。

下面的实验是在收集并分析抛光头(图 1)底部压力分布的情形。利用- & 独一无二的网格化感测器，具有可以设计的感测面积，量测抛光头和晶圆接触表面的压力分布情形。只要在仪器操作、配置时，能够平衡这些压力，就能够协助改善产能与仪器的操作。

- & 系统不但能够收集静态压力资讯，还能够观察动态压力变化的情形。这个实验的结果，如下面的图 2(2-)和图 3(3-)所示。从这两张图中可以观察到，晶圆外围的区域，拥有较低的压力分布。而图 4 则为抛光头与晶圆间，横向截面的压力分布曲线。

此系统支援单件式及多件式感测片的操作使用，当然也包括客户的订制感测系统，亦可设计成能够大范围感测完整区域的单件式感测片。

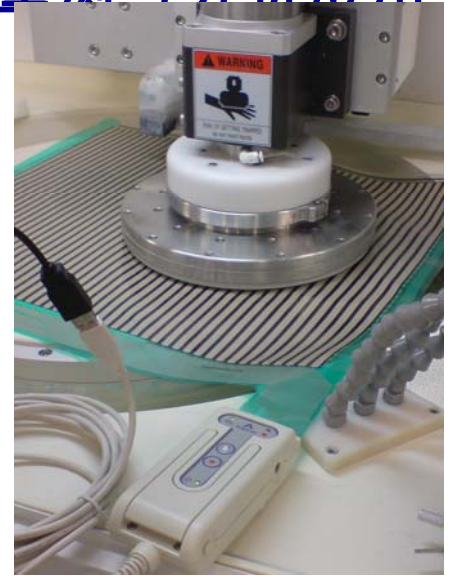


图 1. I-Scan® 感测片置于晶圆底部

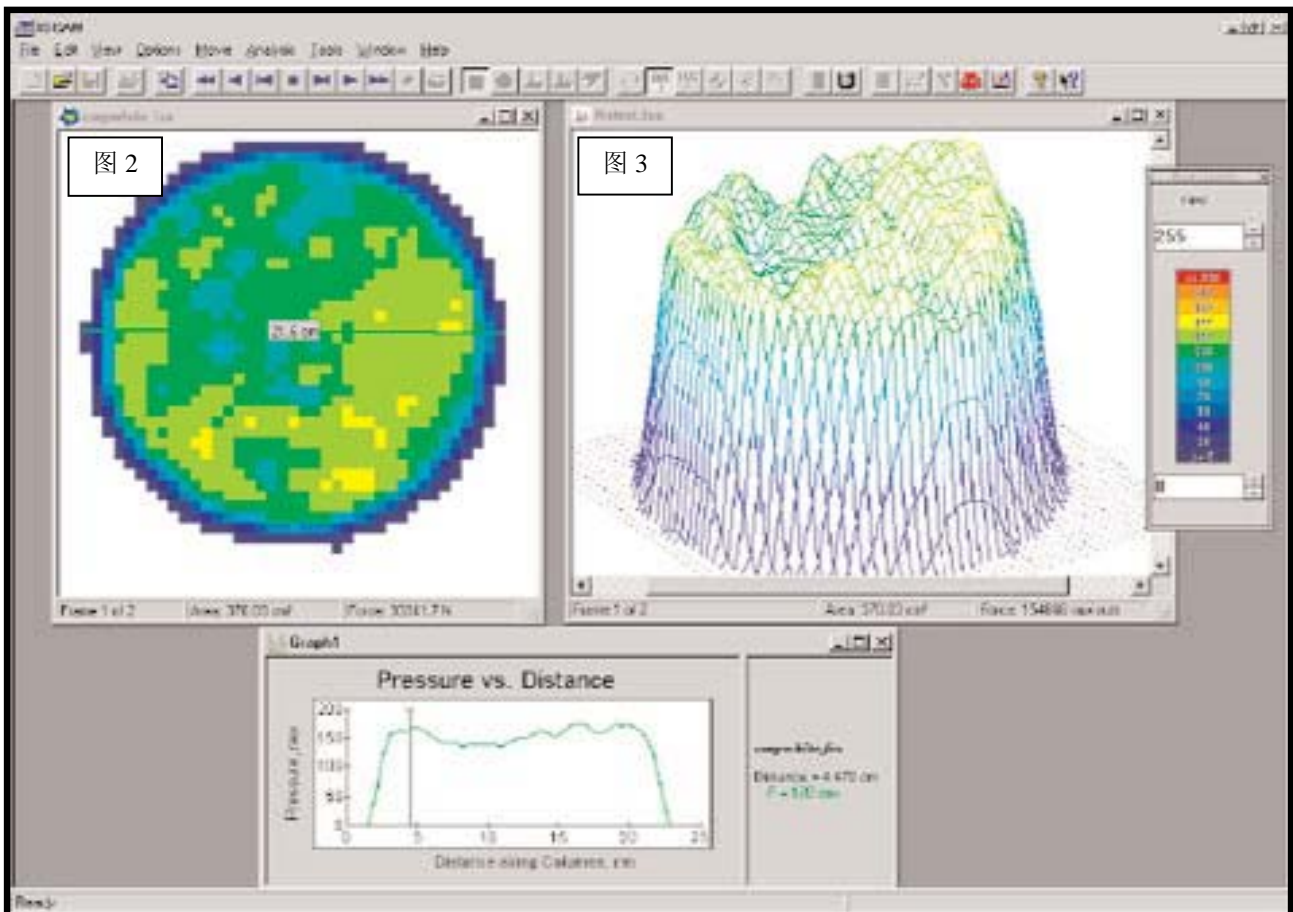


图 4. 晶圆底部之压力分布图形